



2019年2月12日

各 位

会社名 タツモ株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田 俊夫
(東証一部・コード 6266)
問合せ先 専務取締役管理本部長 亀山 重夫
電話番号 0866-62-0923

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の99.6%連結子会社であるアプリシアテクノロジー株式会社（以下、「アプリシアテクノロジー」）を吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収合併は連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

アプリシアテクノロジーは、半導体製造工程で使用される洗浄装置やリン酸再生装置、スラリー供給装置等を開発・販売しております。当社の主力事業であります半導体製造装置と共通する点も多く、経営資源の有効活用、柔軟な人材配置による業務効率の向上および組織基盤の強化を図ることを目的として同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会 2019年2月12日

合併予定日（効力発生予定日） 2020年1月1日

その他の合併の日程、合併比率等については、今後確定次第、お知らせいたします。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、アプリシアテクノロジーは解散いたします。なお、同社は債務超過となっておりますが、本合併に先立ち、当社が同社に対して有する債権の一部を放棄することにより債務超過状態を解消した後、合併する予定です。

放棄する債権の内容 貸付金

放棄する債権の額 562百万円（予定）

実施日 2019年12月27日（予定）

(3) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付負債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当時会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	タツモ株式会社	アプリシアテクノロジー株式会社
(2) 本店所在地	岡山県井原市木之子町 6186	東京都新宿区高田馬場 1-29-8
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 池田 俊夫	代表取締役社長 池田 俊夫
(4) 事業内容	半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置の開発・製造・販売及び精密金型、樹脂成形品の製造・販売	半導体製造用の洗浄装置などの開発・販売
(5) 資本金	2,724 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	1972 年 2 月 26 日	1991 年 9 月 1 日
(7) 発行済株式数	13,508,300 株	9,270 株
(8) 決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社大江屋 16.54% 弘塑科技股份有限公司 8.88% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.59% GOLDMAN, SACHS & CO. REG 3.45% BBH LUX/DAIWA SBI LUX FUNDS SICAV - DSBI JAPAN EQUITY SMALLCAP ABSOLUTE VALUE 2.37% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.27% 中銀リース株式会社 2.25% 鳥越琢史 1.89% 株式会社中国銀行 1.65% THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 1.44%	当社 99.6%
(10) 直近事業年度の経営成績及び財政状態		
	平成 30 年 12 月期	平成 30 年 12 月期
純資産	8,474 百万円	△366 百万円
総資産	18,514 百万円	2,275 百万円
1 株当たり純資産	631 円 74 銭	△39,528 円 14 銭
売上高	11,879 百万円	2,316 百万円
営業利益	1,117 百万円	△55 百万円
経常利益	1,166 百万円	△48 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益／当期純利益	1,181 百万円	△34 百万円
1 株当たり当期純利益	98 円 78 銭	△3,726 円 48 銭

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 業績に与える影響

当社は、本合併に先立ち債権放棄を実施いたしますが、単体決算においては、過年度に貸倒引当金を計上しているため、影響は軽微であります。なお、連結決算においては、アプリシアテクノロジーは当社の連結子会社であるため、本合併が当社の業績に与える影響は軽微です。

以 上